



上市前業績發表會



捷敏股份有限公司
GEM Services, Inc.

壹、本公司之產業、營運及其他重要風險

- | | |
|----------|----|
| 一、產業風險 | P1 |
| 二、營運風險 | P1 |
| 三、其他重要風險 | P2 |

貳、依2015年12月16日臺證上二字第1041706309號函臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項及有價證券上市審議委員會詢問重點

一、補充揭露特別記載事項乙節

- | | |
|--|-----|
| (一)最近三年度及申請(2015)年度前3季業績變化合理性之評估。 | P23 |
| (二)母公司聯鈞光電股份有限公司於2012年投資該公司之緣由、對其發展之影響及效益。 | P38 |
| (三)最近三年度及申請(2015)年度前3季毛利率呈成長趨勢，其原因及相關成本控管情形，未來如何維持經營績效 | P44 |

參、公司治理及企業社會責任 P46

Ahead

Ability

Agility

Accountability

- 公司概况
- 產品介紹
- 競爭優勢
- 經營實績
- 成長動能
- 未來發展

公司概況

- 創立
- 產能
- 特別技術
- 終端應用
- 員工
- 營運據點

- 成立於1998年, 2000年開始量產

- 42億顆年封測產能

- Multi-chip Module (多晶粒模組)
- J-lead Wide Body (內彎腳型封裝)
- Leadless (底部貼焊型) : GEMPAK5060, GEMPAK3333
- Bond-wireless(非鐸線結構) : Flip chip, Cu Clipper

- 電腦, 手機, 手持電子產品
- LCD /電漿顯示器
- 家電產品

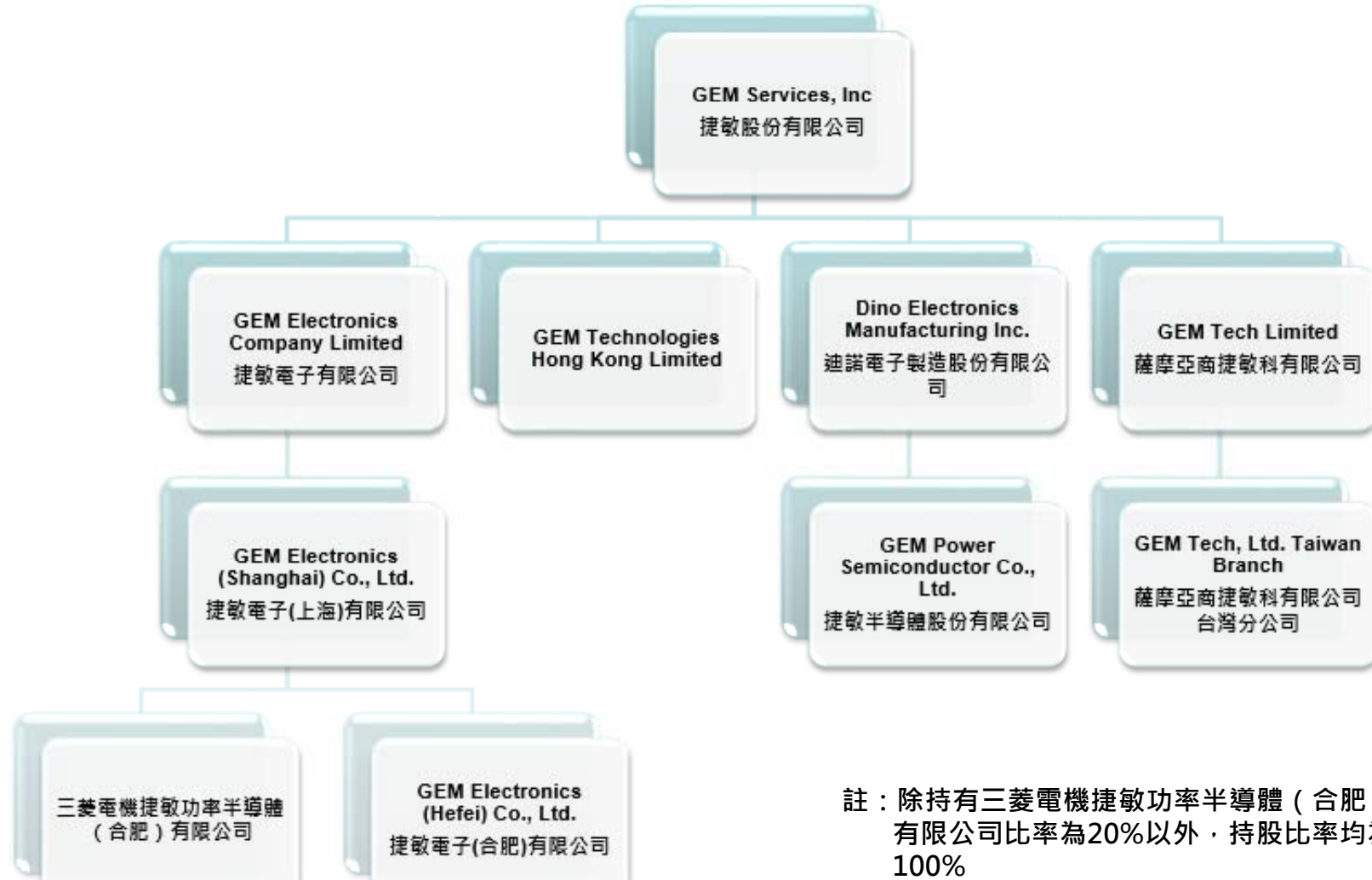
- 員工人數: 1,600+ (技術人員: 470+)

- 總部: 台灣新北市中和區
- 高雄廠: 台灣高雄市前鎮區



- 工業電子系統/LED系統
- 風力/太陽能電力系統
- 電動車/車載電子

- 上海廠: 中國上海市嘉定區
- 合肥廠: 中國安徽省合肥市



註：除持有三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司比率為20%以外，持股比率均為100%

上海廠	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>產能</u>：約36.2億顆/年 ● 土地面積:19,000平方公尺 (租賃) ● 建築佔地面積: 15,400平方公尺 ● 樓地板面積: 17,836平方公尺 ● 無塵室: 7,512平方公尺
高雄廠	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>產能</u>：約4.6億顆/年 ● 土地面積: 3,422平方公尺 (租賃) ● 建築佔地面積: 2,640平方公尺 ● 樓地板面積: 4,965平方公尺 ● 無塵室: 1,113平方公尺
合肥廠	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>產能</u>：約1.2億顆/年 ● 土地面積: 66,667平方公尺 (自有) ● 建築佔地面積: 17,920平方公尺 ● 樓地板面積: 28,588平方公尺 ● 無塵室: 8,069平方公尺

職稱	姓名	國籍	經驗 (年數)	主要學經歷
董事長	鄭祝良	中華民國	31	<ul style="list-style-type: none"> • 美國新澤西州立羅格斯大學 電機博士 • 聯鈞光電股份有限公司 董事長 • 光寶電子光電元件事業部 副總 • AT&T Bell Lab 研究員
副董事長	黃文興	中華民國	27	<ul style="list-style-type: none"> • 中原大學 電子系學士 • 聯鈞光電股份有限公司 總經理 • 光寶電子IR 產品線主管 品保處長
總經理	湯彥鏘	中華民國	34	<ul style="list-style-type: none"> • 亞東技術學院 工業工程學士 • 聯鈞光電股份有限公司 工程協理 • 光寶電子無錫廠 廠長
事業整合部副總 兼發言人	宋天增	中華民國	26	<ul style="list-style-type: none"> • 美國亞特蘭大大學 企管碩士 • 聯鈞光電股份有限公司 副總 • 致福電子 協理

職稱	姓名	國籍	經驗 (年數)	主要學經歷
捷敏上海副總	褚衛兵	中國	22	<ul style="list-style-type: none"> 上海冶金研究所 半導體物理與器件系碩士 捷敏(上海)有限公司 副總經理 Agape Package Manuf. Ltd. (Nasdaq: AOSL) 營運及工程副總
捷敏合肥副總	H.M. Wong (黃熙明)	馬來西亞	45	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學 電機系學士 捷敏(合肥)有限公司副 總經理 Temic Telefunken Microelectronic GmbH 品管協理
捷敏高雄副總	吳俊璟	中華民國	26	<ul style="list-style-type: none"> 高雄應用科技大學 工業工程碩士 捷敏半導體股份有限公司 副總經理 晶傑達光電科技 (原日立電子) 設備技術課長
財務副總	林裕府	中華民國	13	<ul style="list-style-type: none"> 美國馬里蘭大學 財管及資管碩士 捷敏股份有限公司 財務副總 美商華美銀行科技銀行部 第一副總裁

	<u>2016.02.29</u>	
主要股東名稱	持有股數	持股比例
聯鈞光電股份有限公司	51,771,886	55.02%
Kingsway Capital Assets Limited	5,295,124	5.63%
Kulle Revocable Trust Dated November 30, 1996	3,729,779	3.96%
All Nippon Airways Trading Co., Ltd.	3,284,614	3.49%
Singwand Holding Private Limited	2,867,382	3.05%
國際前瞻創業投資股份有限公司	1,573,998	1.67%
敦南科技股份有限公司	1,075,268	1.14%
Central Investment Holding (B.V.I.) Co., Ltd.	1,036,865	1.10%
Chia, Hearn Teck	998,049	1.06%
Pan-Jit Asia International Inc.	935,739	0.99%
合計	72,568,704	77.11%

產品介紹

本公司封裝測試之主要產品為功率電晶體，功率電晶體具有三個端子：基極、集極與射極，作為電流放大或開關之用。這類功率電晶體產品體積雖小，卻是不可或缺的產品。

功率電晶體應用領域非常廣泛，因其特性可承受高電壓、大電流等應用領域，如電源供應器、變壓器、汽車ABS 電路、安全氣囊、照明電子安定器等；再者，由於其切換效率與低阻抗(省電)特性，配合薄型封裝，特別適合應用於行動式電子產品，如手機、筆記型電腦、鋰電池等。

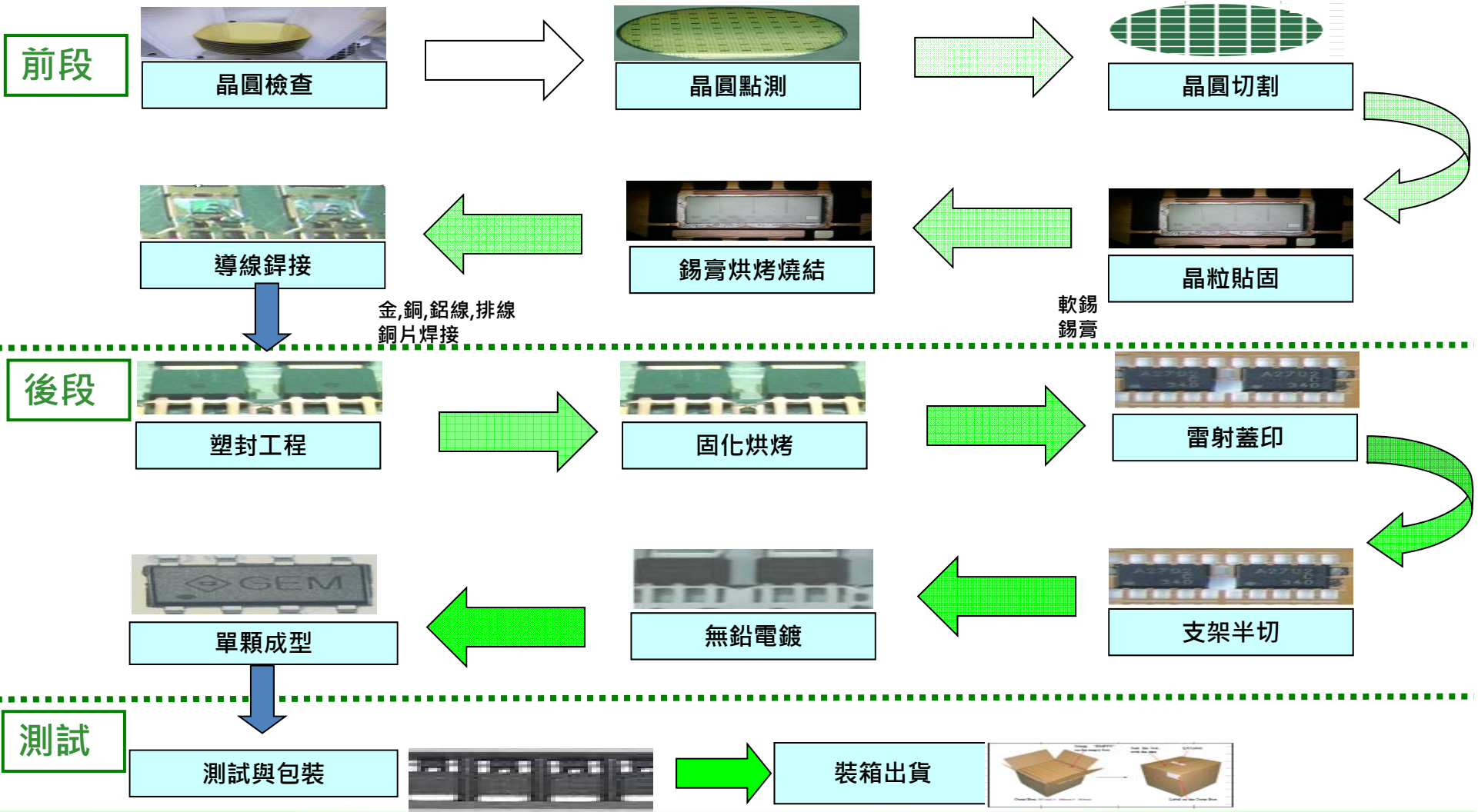
總結來說，其應用主要可分為功率轉換/放大、切換開關、線路保護、整流等。


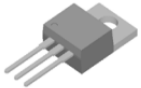
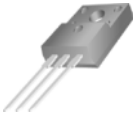


Semi市場規模 (億美元)	2013年	2014年	2015年(e)	2016年(f)	2017年(f)	2018年(f)	CAGR
資訊電子應用	1,239	1,344	1,375	1,344	1,374	1,463	3.4%
通訊電子應用	941	1,006	1,090	1,096	1,136	1,190	4.8%
消費性電子應用	383	402	421	417	416	435	2.6%
汽車電子應用	268	292	311	331	353	369	6.6%
產業電子應用	290	317	348	366	397	438	8.6%
軍事與航太電子應用	33	37	38	38	39	41	4.4%
Total Semi	3,154	3,398	3,583	3,592	3,715	3,936	4.5%

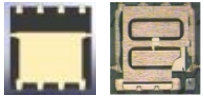



資料來源：Gartner；工研院IEK(2015/02)

- 提供高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、二極體(Diodes)及電源轉換或電源管理IC (Power Management ICs)之封裝測試服務
- 主要應用於主機板、筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、電源供應器、顯示器、白色家電、充電器、轉接器、消費性電子產品之儲存設備等終端應用產品, 以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具等

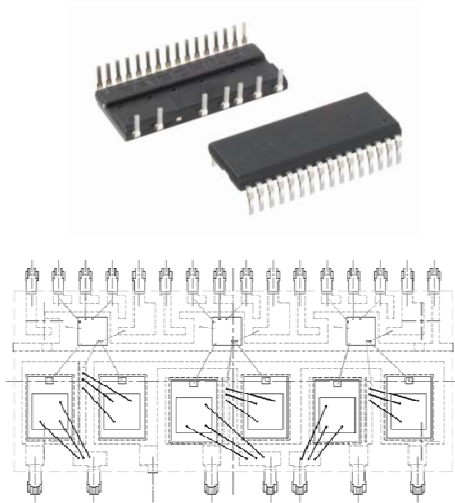
	End Product	Application	Package
Communications	Equipment UPS Router	Power Supplies AC-DC Converter DC-DC Converter	TO277 TO220 TO220FP D2PAK SO8
Desktop/Notebook	PC Server Printer Disc Drive Note Book Adapter Battery Pack	Mother Board, Server blades AC - DC, DC - DC converters Power Supplies, Load Switch TSOP3.5/6 2021/2928	D2PAK PDFN5X6 SO8 DPAK I2PAK IPAK TO277 DFN 3.3X3.3
Home Appliances	LED TV Dish and Washing Machine Microwave Induction Rice Cooker and Cooker Air Con	Power Supplies Inverter Control & PFC Circuit Magnetron Driver Induction Heating Compressor Driver	TO247 TO220FP TO220 TO277
Industrial/Lightings	Welder Solar Cell Machine Tool Lightings Heater Electric Saw Power Drill Motor	Motor Controller Booster Block & Inverter Block Power Supplies	I2PAK TO247 TO220 D2PAK TO220FP
Automotives		ABS, Airbag, Power Window Power Steering Wheel	TO247 TO220 DPAK D2PAK



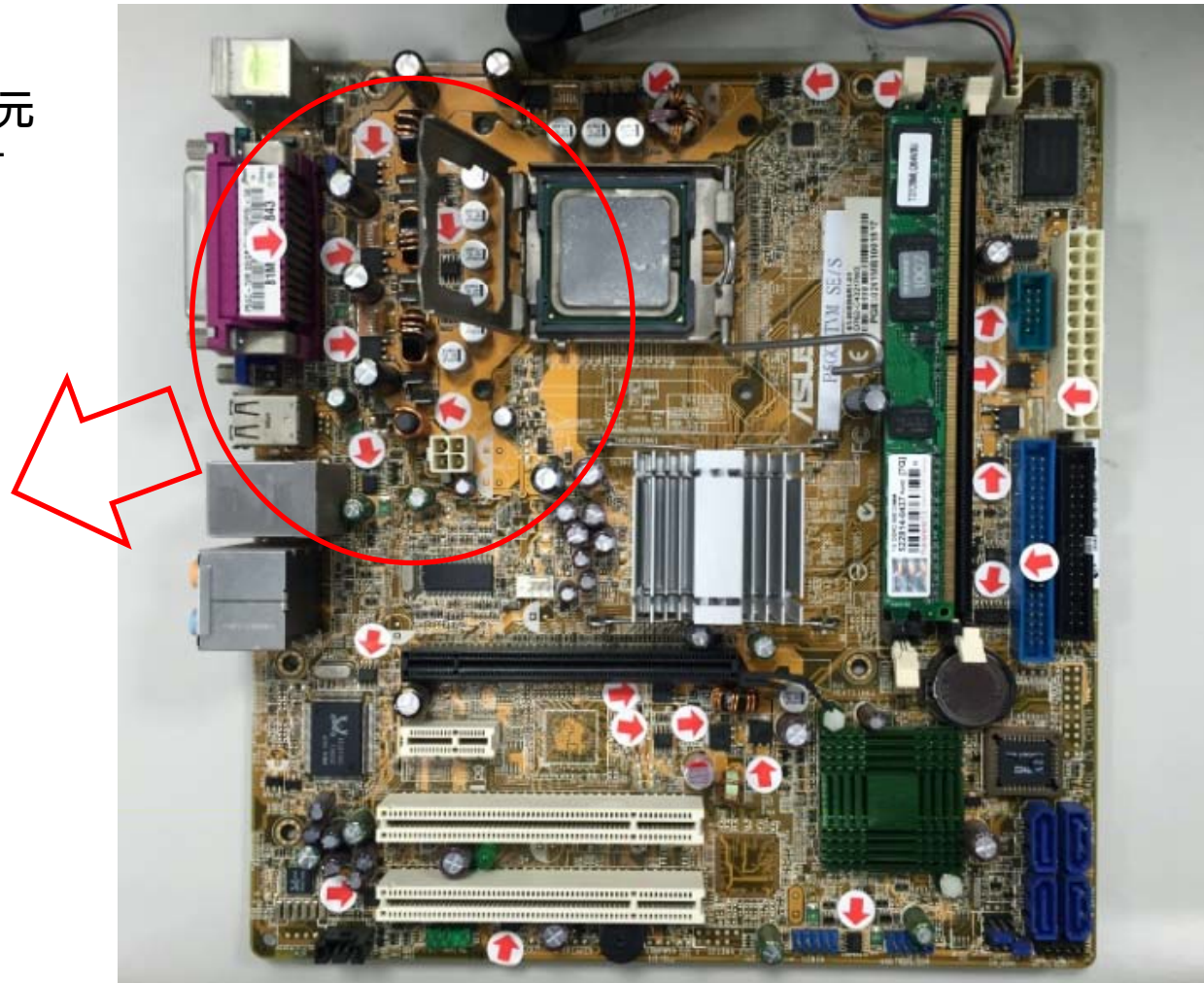
Package	Voltage	1 st Capa	Site	Sample	M.P.
 TO247AD	1,000V	0.5Mpcs	GEMSH	Feb-15	Jul-15
 TO220	650V	2.0Mpcs	GEMHF	Apr-15	Jun-15
 TO220FP	650V	2.0Mpcs	GEMSH	Jul-13	Dec-13
		4.0Mpcs	GEMHF	Dec-14	Apr,15
 TO277	600V	8.0Mpcs	GEMSH	Aug-13	Oct-13
 TO251AA	650V	3.0Mpcs	GEMSH	Dec-13	Mar-14

Package	Voltage	1 st Capa	Site	Sample	M.P.
 <p>GEMPAK5060 銅片焊接 (雙晶結合, 低阻抗, 高信賴度封裝)</p>	650V	5.0Mpcs	GEMSH	Feb-15	Jul-15
 <p>SOP8 鋁排線鐳接 (低阻抗, 高信賴度封裝)</p>	650V	1.5Mpcs	GEMSH	Jan-15	Mar-15
 <p>SOIC8 電源管理 IC (650V)</p>	40V/0.6W (650V)	3.0Mpcs	GEMSH	Jan-15	Mar-15
 <p>GEM3333 鋁排線鐳接 (低阻抗, 高信賴度封裝)</p>	100V	3.0Mpcs	GEMSH	Apr-15	May-15

整合調控 IC 與 功率晶體元
件合一之模組化產品設計

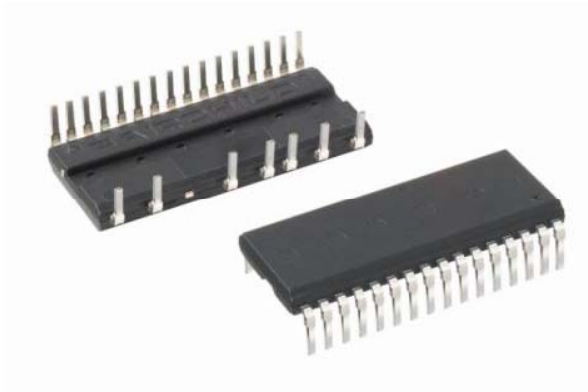


- 產品效能提升
- 使用設計簡易
- 綜合成本降低



- Type of Module

Lead frame base



Substrate base



- Partnership in

- Package design
- Material Sourcing
- Process set up
- Production & Logistic

競爭優勢

- 產業經驗豐富之經營及技術研發團隊
- 專注功率半導體封裝測試領域，技術優於同業水準
 - 品質認證體系完整，確認管理運作之健全
 - 製程與產品品質輸出充分滿足客戶要求
 - 擁有先進電源管理封裝測試專利技術 61件
- 客戶穩定且分散適中，並多為國際領先IDM大廠及半導體設計公司
 - 客戶來自美、日、韓、台等地區之業界領導廠家
 - 無業務集中單一區域或單一客戶風險
- 擁有獨立自主的研發能力
 - 先進電源管理封裝測試專利技術: 49 (美)、 2 (日)、 10 (中)

ISO 9001:2000/2008

Certification Date: April 16, 2004

ISO/TS 16949:2002/2009

Certification Date: June 17, 2004

ISO14001:1996/2004

Certification Date: Aug 16 2002

GEM-SH



Certificate
Green Partner



Sony Green Partner

Certification Date: 14, May, 2003

Mitsubishi Green Accreditation Rank A

Certification Date: March 2, 2009

GEM-HF

ISO 9001:2008

Certification date: Apr 11, 2008

ISO 14001:2004

Certification Date: Apr 11, 2008

ISO/TS 16949:2002

Certification Date: Apr 9, 2009



GEM-KH

ISO 9001:2000/2008

Certification Date :Dec 11, 2003

ISO14001:1996/2004

Certification Date :Nov 12, 2003

ISO/TS 16949:2009

Certification Date :Dec 5, 2012



Operation Excellence Awards



NEC

Best Outsourcing Partner



Toyota

Note of Quality Contribution



Mitsubishi

Rank A Green Supplier



NIEC

Excellent Outsourcing Supplier

Operation Excellence Awards



Magnachip
Rank # 1 in All Subcons



Analogic Tech (Skyworks)
Outstanding Supplier



International Rectifier (IR)
OSAT Best Partner



Fairchild
Supplier of the Year

Jiading Government



Excellent Manager Award



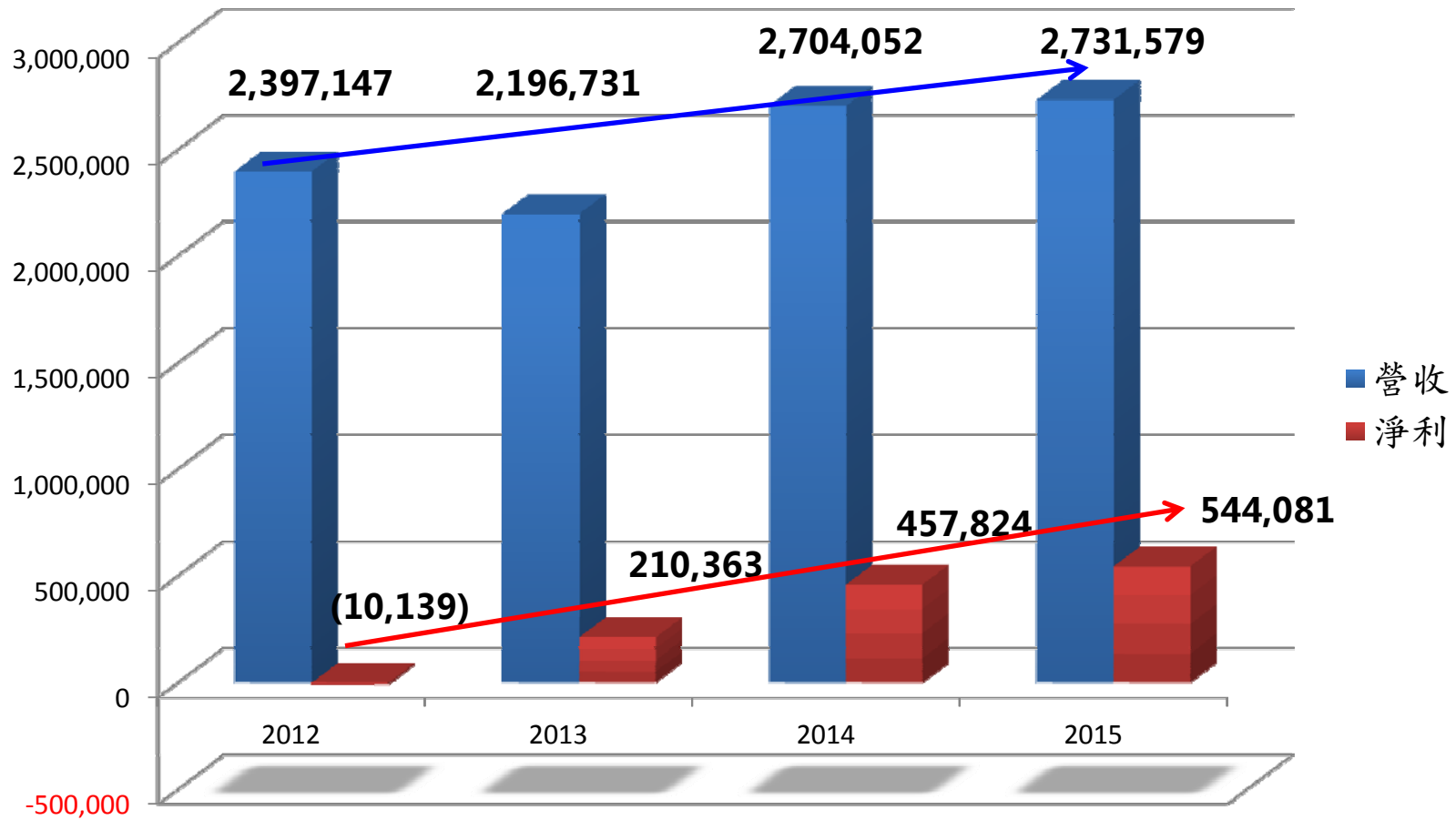
Energy Conservation & Emission Reduction



Integrated Strength Award

經營績效

新台幣仟元



新台幣：仟元

項目	2012年		2013年		2014年		2015年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,397,147	100.0	2,196,731	100.0	2,704,052	100.0	2,731,579	100.0
營業毛利	656,059	27.4	461,793	21.0	737,189	27.2	863,037	31.6
營業費用	389,041	16.2	229,218	10.4	303,837	11.2	275,848	10.1
營業利益	267,018	11.2	232,575	10.6	433,352	16.0	587,189	21.5
本期淨利	(10,139)	(0.4)	210,363	9.6	457,824	16.9	544,081	19.9
EPS (元)	(0.16)	-	2.45	-	5.15	-	5.82	-

新台幣：仟元

項目	2012年		2013年		2014年		2015年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	658,366	29.1	602,171	28.4	690,343	27.8	1,044,911	34.9
應收款項	319,382	14.1	357,259	16.8	397,308	16.0	489,625	16.3
存貨	105,449	4.7	72,696	3.4	121,417	4.9	132,296	4.4
總資產	2,261,082	100.0	2,121,745	100.0	2,483,397	100.0	2,995,976	100.0
短期借款	9,082	0.4	8,590	0.4	-	-	-	-
應付款項	200,012	8.9	149,733	7.1	207,508	8.4	265,054	8.9
長期借款	848,026	37.5	381,504	18.0	56,141	2.3	10,556	-
總負債	1,507,060	66.7	1,055,760	49.8	859,601	34.6	818,082	27.3
股東權益	754,022	33.3	1,065,985	50.2	1,623,796	65.4	2,177,894	72.7
每股淨值(元)	8.79		12.19		17.70		23.14	

成長動能

- 功率半導體需求受惠於工業用電子、汽車電子、無線通訊基礎建設及物聯網等嵌入式系統需求已持續復甦，市場規模可望成長到140億美元規模並創歷史新高
- 捷敏客戶群不限於IDM，尚包括IC設計公司，且應用產品廣及消費性電子、工業產品及家電等領域，不致因單一產業或單一類型客戶之營運變化而對公司營運造成重大影響
- 封測業者如日月光、長電(中國江蘇)及富士通(中國江蘇) 仍以微處理器、存儲器及通用邏輯積體電路之封測為主軸，功率半導體封測業務在其總產能配置調度上難免有排擠效應；相較之下，捷敏專注於功率半導體封測服務，將來紅色供應鏈於長電、富士通接單排擠效應之溢出，反而有利捷敏業務成長

Worldwide Power Transistor Sales



Source: WSTS, IC Insights

未來發展

- 深耕既有客戶，提高下單比例。
- 持續開發新客戶，增加產能利用率。
- 持續開發高單價產品市場。
- 持續擴展高雄廠之營運規模，持續改善獲利。
- 擴充合肥廠產能，專注高電壓產品開發與生產。
- 持續管控成本，提高競爭門檻，鞏固競爭力